

# 2022年3月期（2021年4月～2022年3月） 東京エレクトロン 決算説明会

2022年5月12日

内容：

- 2022年3月期 連結決算の概要      取締役 専務執行役員      布川 好一
- 事業環境および業績予想      代表取締役社長・CEO      河合 利樹

# 将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の事業計画、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスク、新型コロナウイルスの影響など、さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置およびFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、為替レート変動による利益への影響は極めて軽微です。

FPD：フラットパネルディスプレイ

# 2022年3月期 連結決算の概要

2022年5月12日

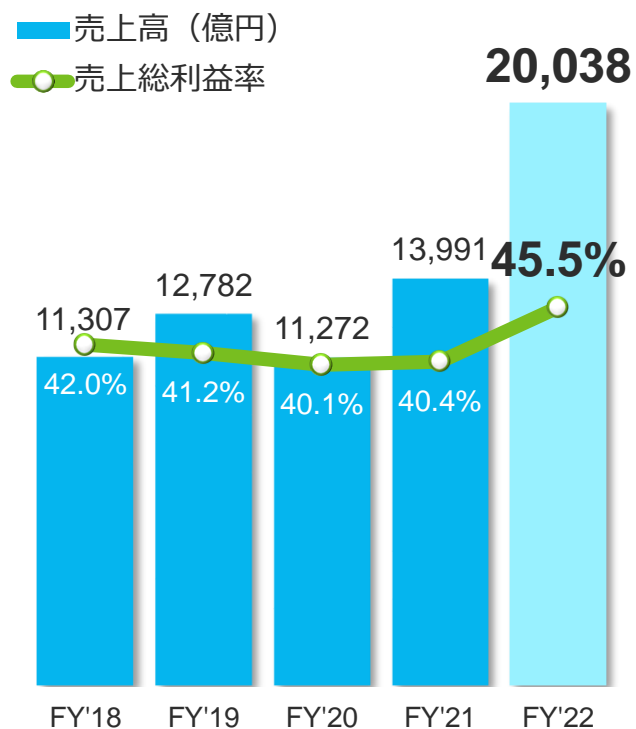
布川 好一

取締役 専務執行役員 Global Business Platform本部長

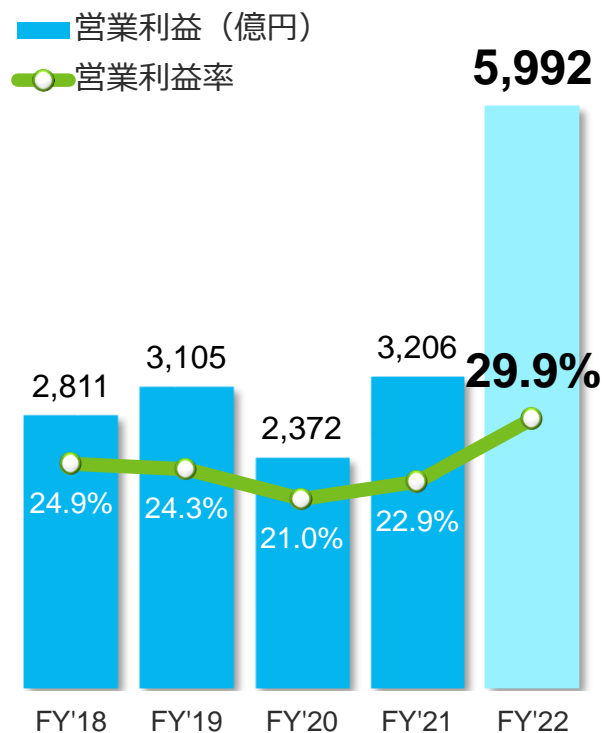


# FY2022（2021年4月～2022年3月）財務ハイライト

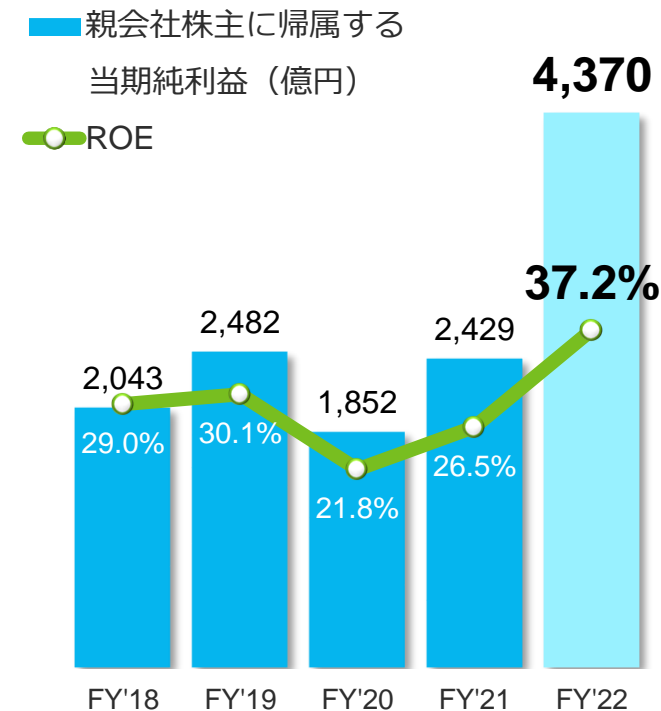
## 売上高と売上総利益率



## 営業利益と営業利益率



## 親会社株主に帰属する 当期純利益とROE



- SPE\*1需要の拡大に確実に対応。前期比+43%\*2の増収
- 利益率・ROEともに過去最高を大きく更新

\*1 SPE：半導体製造装置

\*2 FY2022の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用しています。増減率は適用前のFY2021の連結業績をもとに算定しています。

# 損益状況

新収益認識基準

(億円)

	FY2021	FY2022	対前期 増減*	(ご参考) 2022年2月10日発表 のFY2022予想
売上高	13,991	20,038	+43.2%	19,500
SPE	13,152	19,438	+47.8%	18,900
FPD	837	598	-28.6%	600
売上総利益 下段：売上総利益率	5,649 40.4%	9,118 45.5%	+61.4% +5.1pts	8,840 45.3%
販管費	2,442	3,125	+28.0%	3,140
営業利益 下段：営業利益率	3,206 22.9%	5,992 29.9%	+86.9% +7.0pts	5,700 29.2%
税金等調整前当期純利益	3,170	5,966	+88.2%	5,680
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,429	4,370	+79.9%	4,160
1株当たり当期純利益 (円)	1,562.20	2,807.84	+79.7%	2,672.51
研究開発費	1,366	1,582	+15.8%	1,650
設備投資額	538	572	+6.3%	640
減価償却費	338	367	+8.5%	430

1. 当社の主力製品である半導体製造装置およびFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、為替レート変動による利益への影響は極めて軽微です。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

\* FY2022の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用しています。増減率は適用前のFY2021の連結業績をもとに算定しています。

# 損益状況 (四半期)

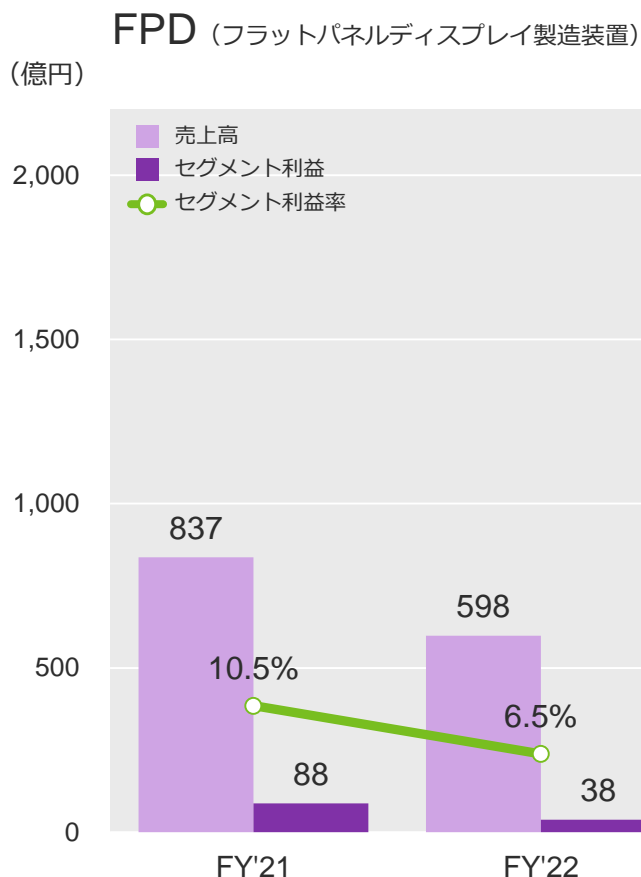
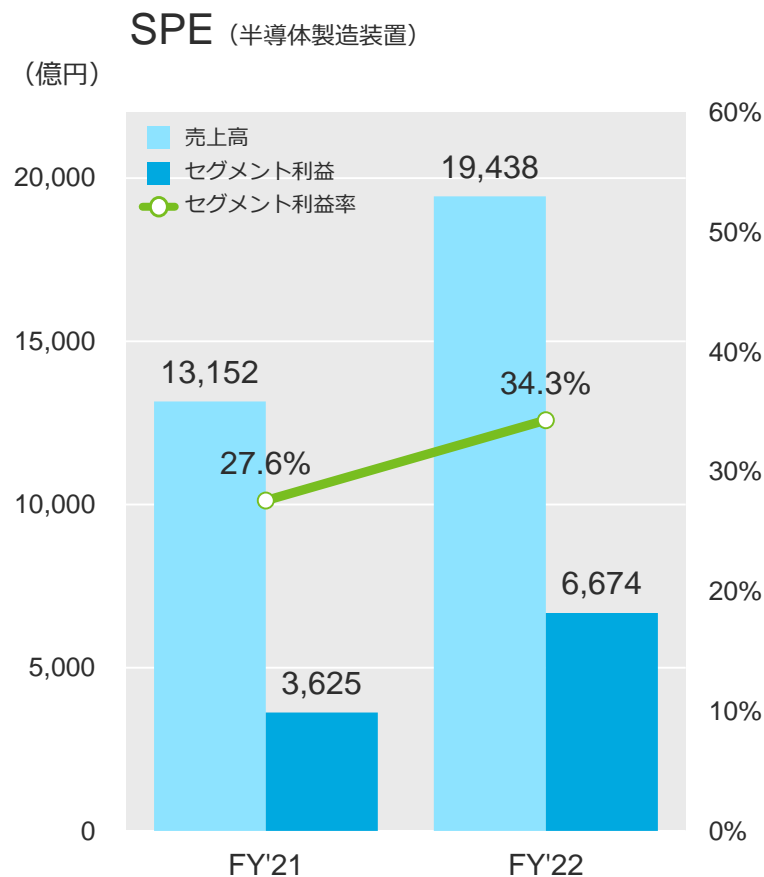
新収益認識基準

(億円)

	FY2021	FY2022				対FY2022 Q3 増減
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
売上高	4,392	4,520	4,804	5,064	5,648	+11.5%
SPE	4,154	4,379	4,678	4,888	5,492	+12.4%
FPD	237	140	125	176	155	-12.1%
売上総利益	1,782	2,109	2,119	2,330	2,559	+9.8%
下段：売上総利益率	40.6%	46.7%	44.1%	46.0%	45.3%	-0.7pts
販管費	678	691	790	769	873	+13.5%
営業利益	1,103	1,417	1,328	1,560	1,685	+8.0%
下段：営業利益率	25.1%	31.4%	27.7%	30.8%	29.8%	-1.0pts
税金等調整前当期純利益	1,069	1,380	1,350	1,555	1,681	+8.1%
親会社株主に帰属する 当期純利益	847	1,003	998	1,100	1,268	+15.3%
研究開発費	371	343	411	385	441	+14.6%
設備投資額	168	106	145	174	147	-15.4%
減価償却費	97	79	88	96	102	+6.3%

1. 当社の主力製品である半導体製造装置およびFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、為替レート変動による利益への影響は極めて軽微です。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

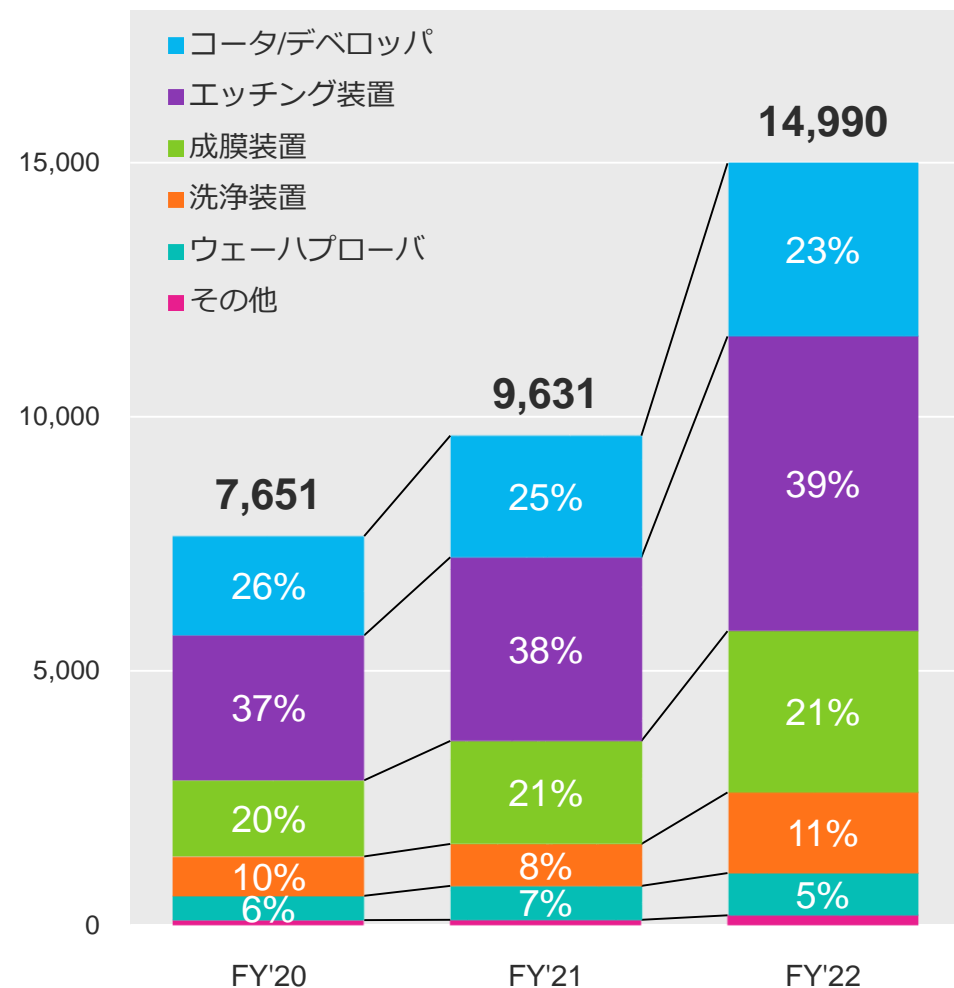
# セグメント情報



1. セグメント利益は、税金等調整前当期純利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない基礎研究又は要素研究等の研究開発費、およびその他の一般管理費等があります。
3. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。

# SPE部門 新規装置 製品別売上構成比

(億円)

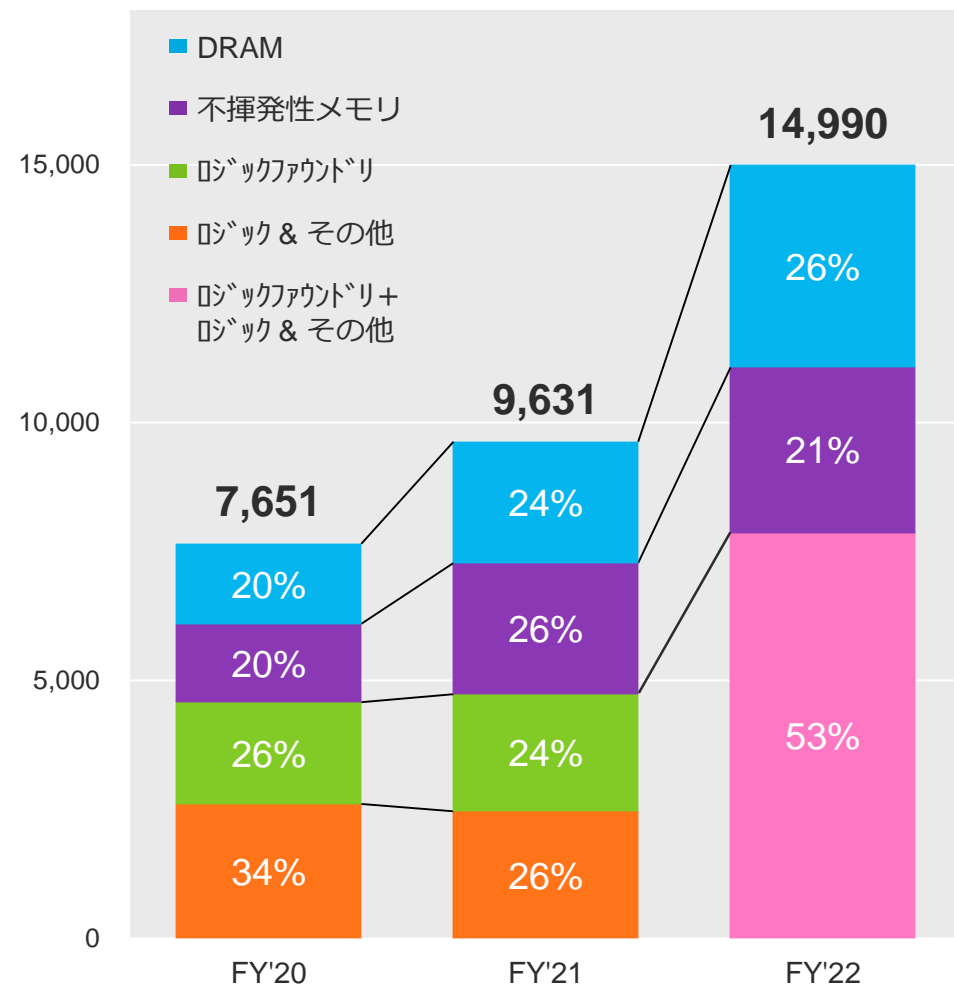


- FY2022 新規装置の売上は、前期比+56%の 14,990億円
- 主力装置におけるシェア上昇に加え、急速な需要拡大への対応が奏功し、すべての製品において売上は前期比増加



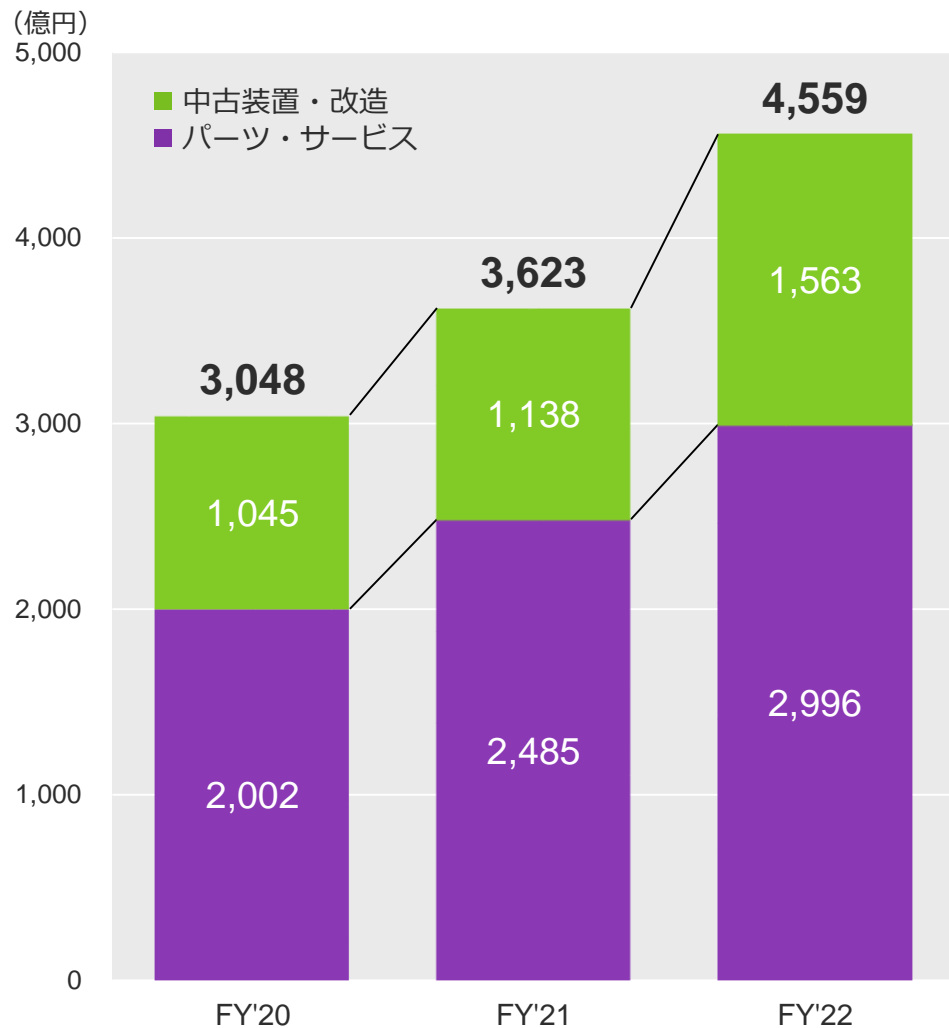
# SPE部門 新規装置 アプリケーション別売上構成比

(億円)



- すべてのアプリケーションにおいて、売上が増加
- ロジック/ファウンドリでは、最先端から成熟世代にかけて幅広い世代における旺盛な投資を背景に、売上が大きく伸長
- DRAMにおいては、顧客の設備投資の回復に加え、新たに獲得したPORが売上貢献

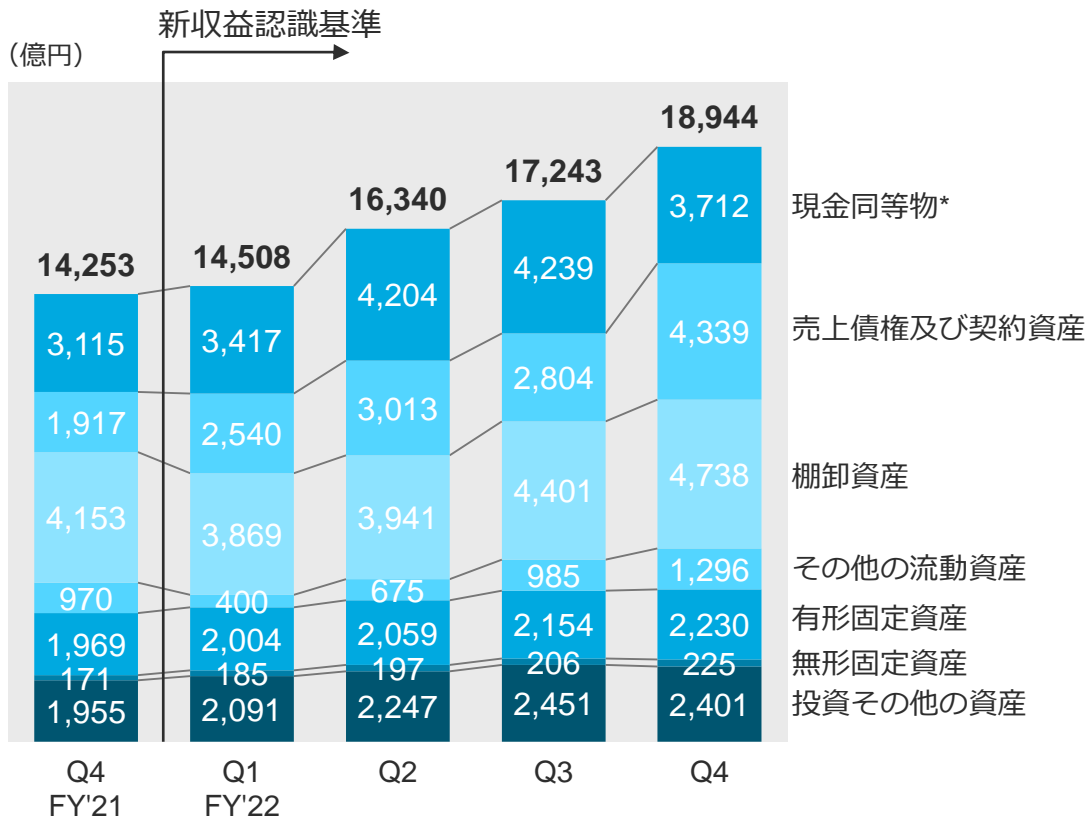
# フィールドソリューション売上



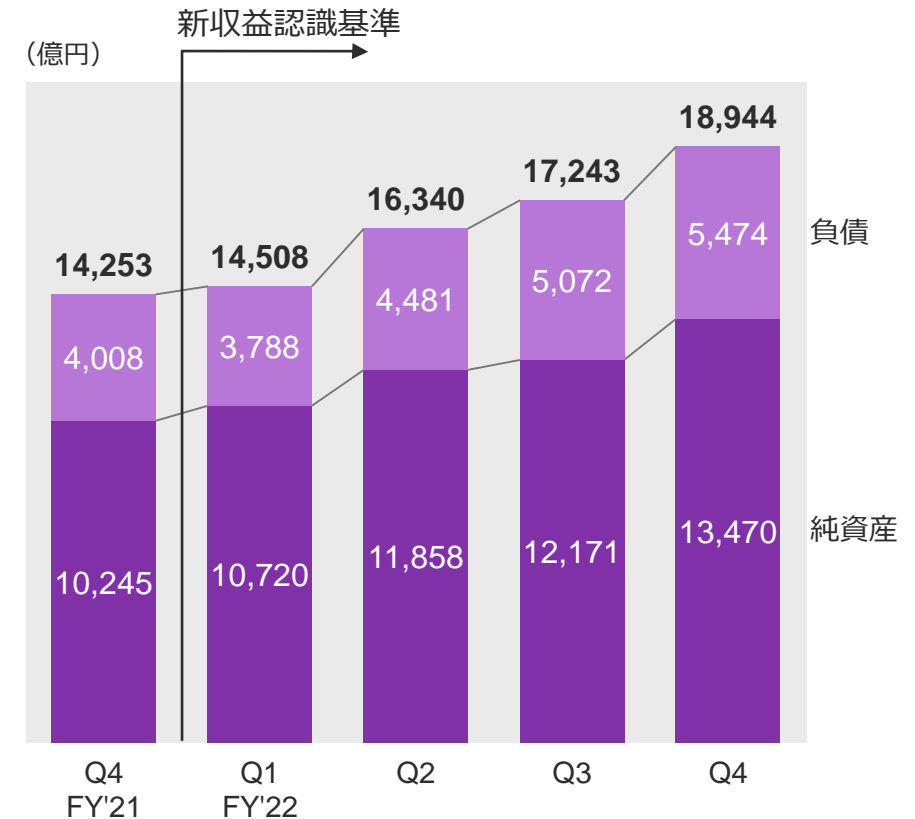
- FY2022 フィールドソリューションの売上は、前期比+26%の4,559億円
- パーツ・サービス売上は前期に引き続き堅調。旺盛な成熟世代向けの需要に牽引され、改造売上も大幅に増加

# 貸借対照表（四半期）

## 資産

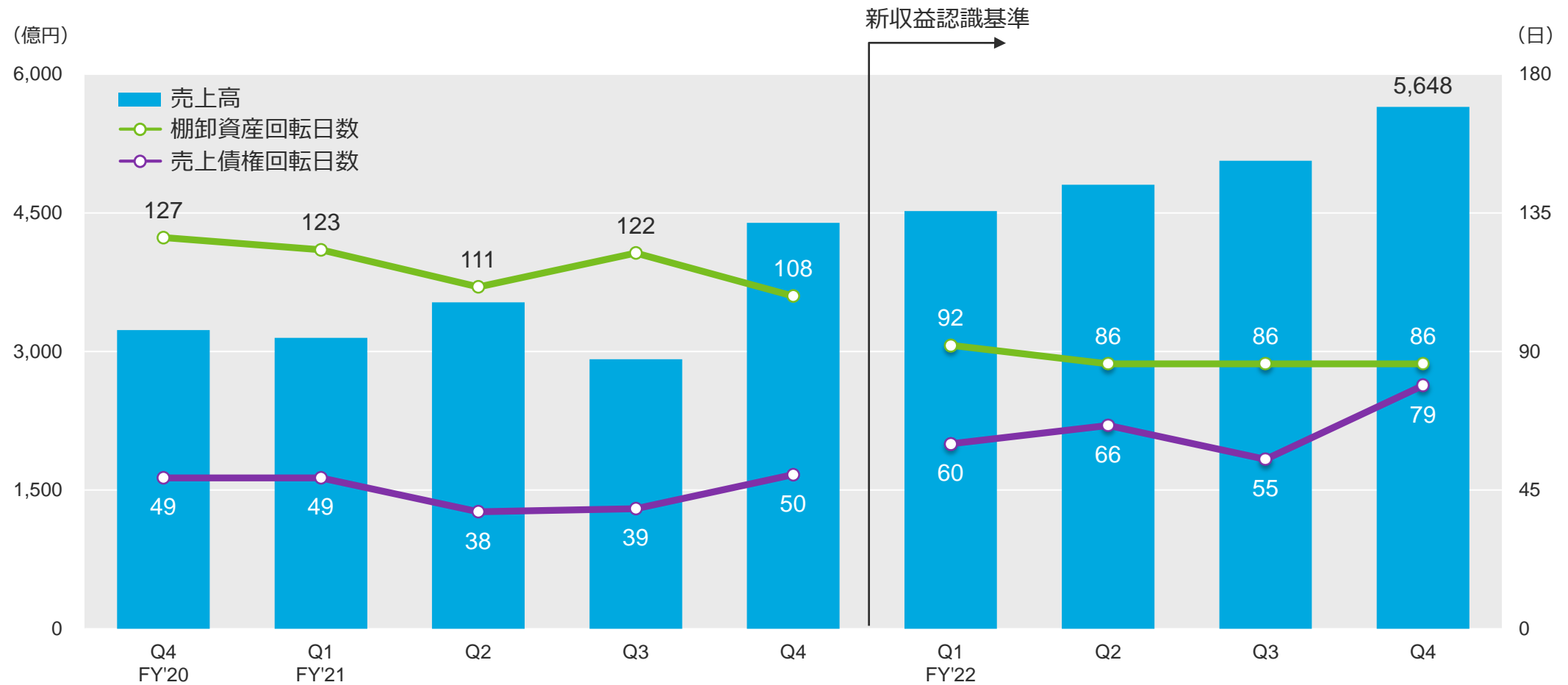


## 負債・純資産



\* 現金同等物：現預金 + 短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

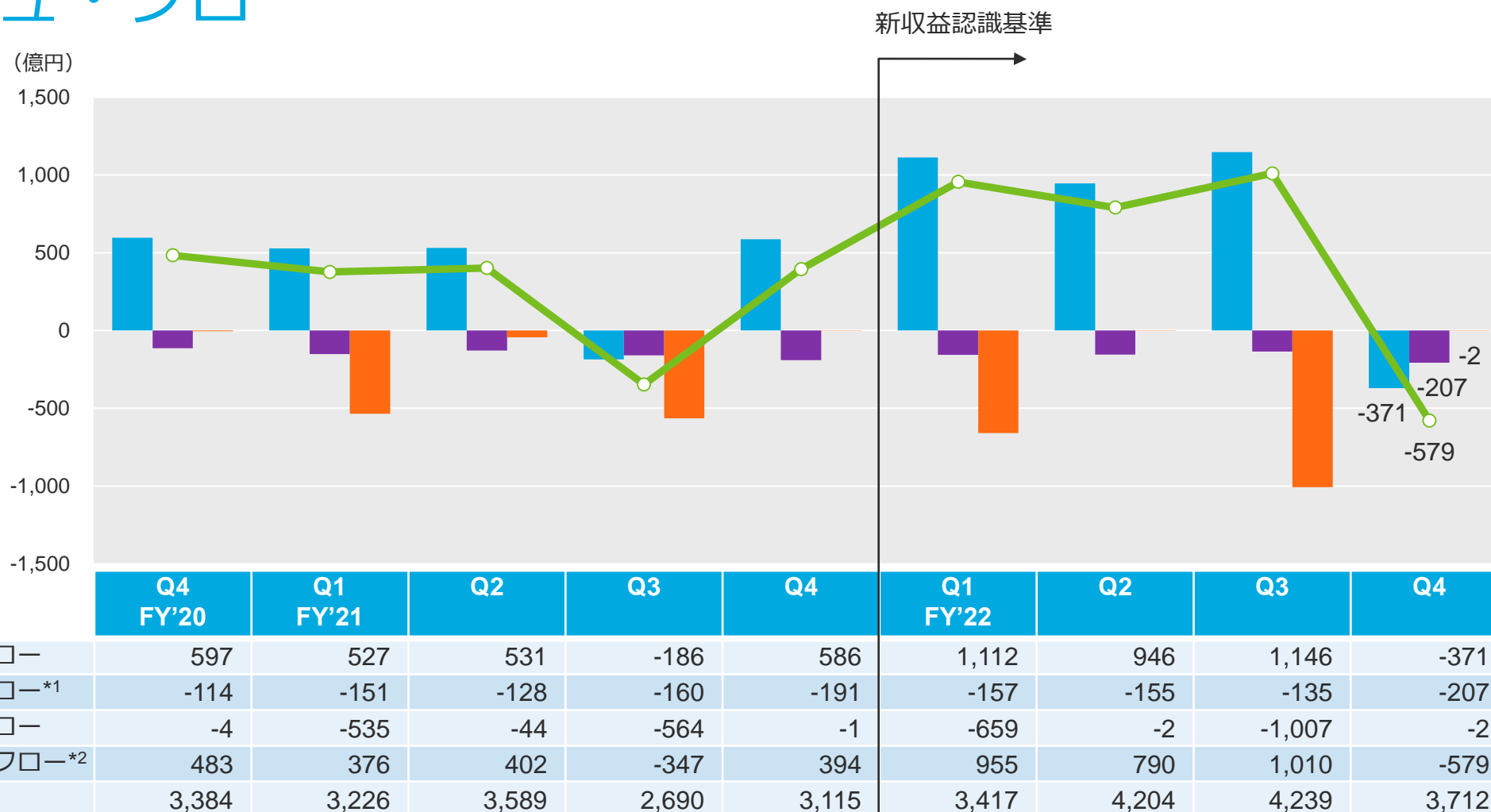
# 棚卸資産・売上債権の回転日数



回転日数 = 売上債権もしくは棚卸資産 ÷ 各四半期末までの12カ月間売上高 × 365  
 (売上債権には契約資産を含みます)

FY'22の回転日数については、収益認識基準は異なりますが、それぞれ当該四半期を含む過去4四半期の売上高に基づいて算出しています。

# キャッシュ・フロー



\*1 投資キャッシュ・フローは、定期預金および短期投資の増減を除いた金額です。

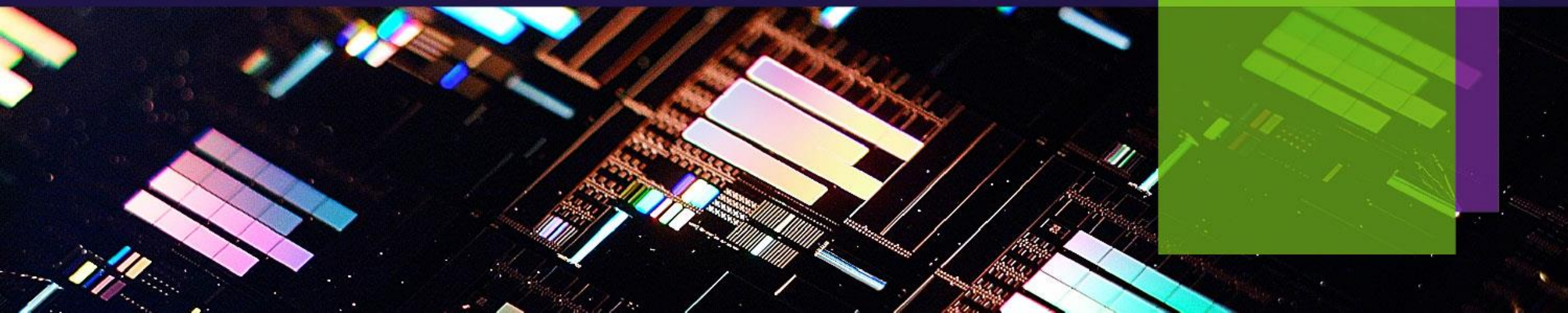
\*2 フリーキャッシュ・フロー = 営業キャッシュ・フロー + 投資キャッシュ・フロー (定期預金および短期投資の増減を除く)

\*3 手元資金は、現金及び現金同等物と満期日または償還日までの期間が3カ月を超える定期預金および短期投資の合計額です。

# 事業環境および業績予想

2022年5月12日

河合 利樹  
代表取締役社長・CEO



# FY2022 事業ハイライト

- 売上高、利益ともに過去最高を更新。  
中期経営計画\*の財務モデルを2年前倒しで達成
  - 売上高 2兆円超、営業利益率 29.9%、ROE 37.2%
  - 付加価値の高い戦略装置でPORを獲得し、売上・利益に貢献。  
主力装置のマーケットシェアも上昇
  - フィールドソリューションの売上高も目標を上回る
  - 急速な市場拡大に対応したプロアクティブな調達と生産を実行
  - 将来成長を見据え、過去最大となる1,582億円の研究開発投資、  
572億円の設備投資を実施

\* 2019年5月28日発表の中期経営計画

## CY2022 事業環境（2022年5月時点での見方）

- 半導体前工程製造装置 (WFE)\*<sup>1</sup>市場
  - 前年比 2割程度の成長を見込む。  
社会のデジタルシフトの進展による、先端から成熟にかけて幅広い世代のロジックやメモリ需要の拡がり市場成長を牽引
- FPD製造装置市場 (TFTアレイ工程)\*<sup>2</sup>向け)
  - 前年比微増を見込む。  
車載など新たなアプリケーションやモバイルの新技術採用に伴う投資が増加。  
LCDからOLEDへの移行は小型パネルから進行しており、今後は大型パネルへの展開も期待

\*1 半導体前工程製造装置 (WFE; Wafer fab equipment) : 半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、そのウェーハをチップごとに切断し、組み立て・検査をする後工程があります。半導体前工程製造装置は、この前工程で使用される製造装置です。また半導体前工程製造装置は、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含んでいます。

\*2 TFTアレイ工程 : ディスプレイを駆動する電気回路機能をもつ基板を製造する工程



## CY2022 アプリケーション別のWFE市場環境

- ロジック/ファウンドリ：前年比 25%程度の増加
  - 情報通信技術の推進に伴うアプリケーションの拡大により、積極的な投資が継続し、市場成長を牽引
- DRAM：前年比 15%程度の増加
  - 5Gモバイルの普及やデータセンター需要の増加、DDR5の進展により、高水準の投資を見込む
- 不揮発性メモリ：前年比 10%程度の増加
  - SSDの採用の進捗と搭載容量の増加により、堅調な投資が継続

# FY2023 業績予想

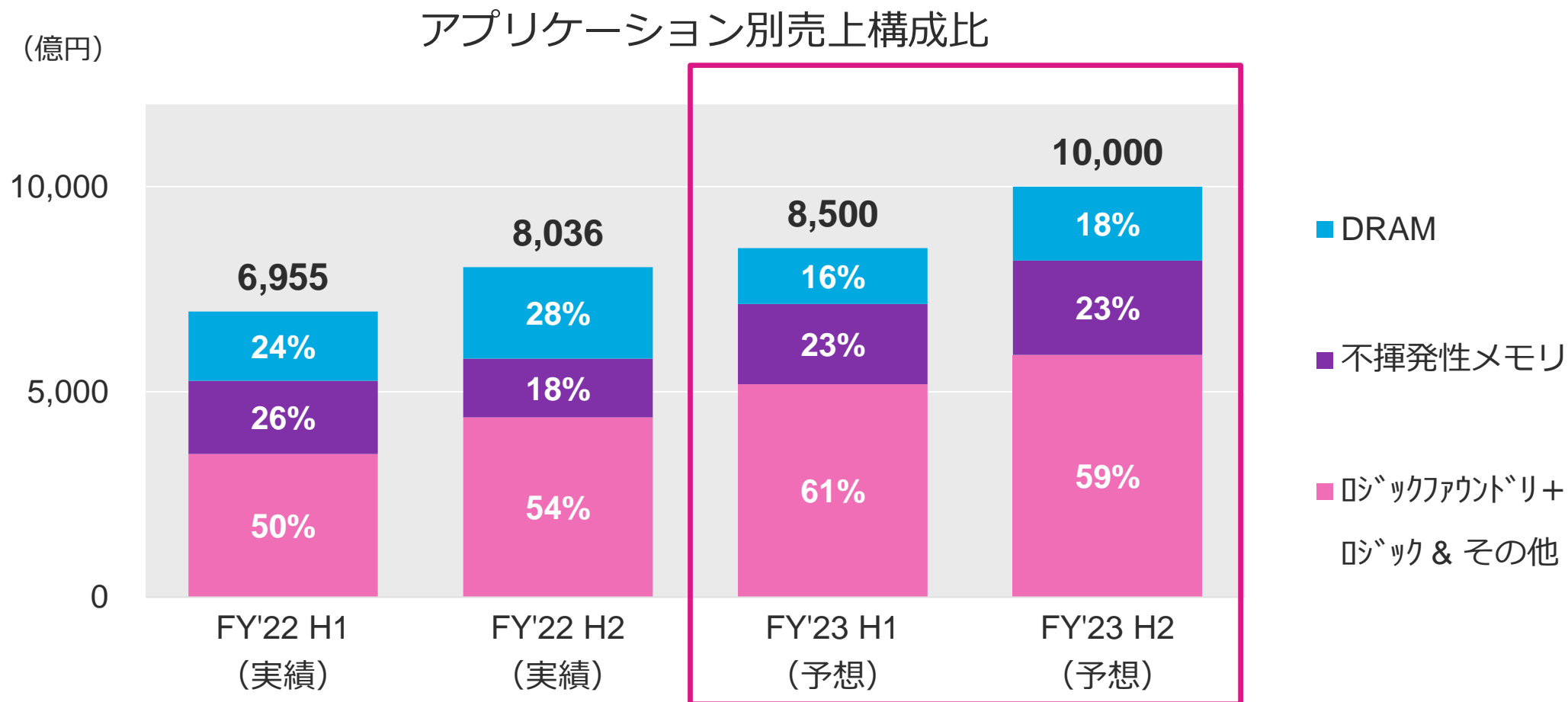
# FY2023 業績予想

(億円)

	FY2022 (実績)	FY2023 (予想)			
		H1	H2	通期	通期 対前期増減
売上高	20,038	11,000	12,500	23,500	+17.3%
SPE	19,438	10,700	12,250	22,950	+18.1%
FPD	598	300	250	550	-8.1%
売上総利益	9,118	4,950	5,800	10,750	+17.9%
下段：売上総利益率	45.5%	45.0%	46.4%	45.7%	+0.2pts
販管費	3,125	1,760	1,830	3,590	+14.9%
営業利益	5,992	3,190	3,970	7,160	+19.5%
下段：営業利益率	29.9%	29.0%	31.8%	30.5%	+0.6pts
税金等調整前当期純利益	5,966	3,190	3,970	7,160	+20.0%
親会社株主に帰属する 当期純利益	4,370	2,340	2,890	5,230	+19.7%
1株当たり当期純利益 (円)	2,807.84	1,502.41	-	3,357.96	+550.12

過去最高の売上高、利益を見込む

# FY2023 SPE部門 新規装置売上予想



投資拡大に伴いロジック向け売上増。メモリ向けも高レベルを維持

グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューション売上高を含んでいません。

# FY2023 研究開発費・設備投資計画

- 研究開発費 1,900億円
  - 注力分野および持続的成長を見据えた投資
- 設備投資 750億円
  - 先端技術開発・増産対応への積極的な投資
- 減価償却費 460億円

新開発棟  
(コータ/デベロッパ、サーフェスプレパレーション)

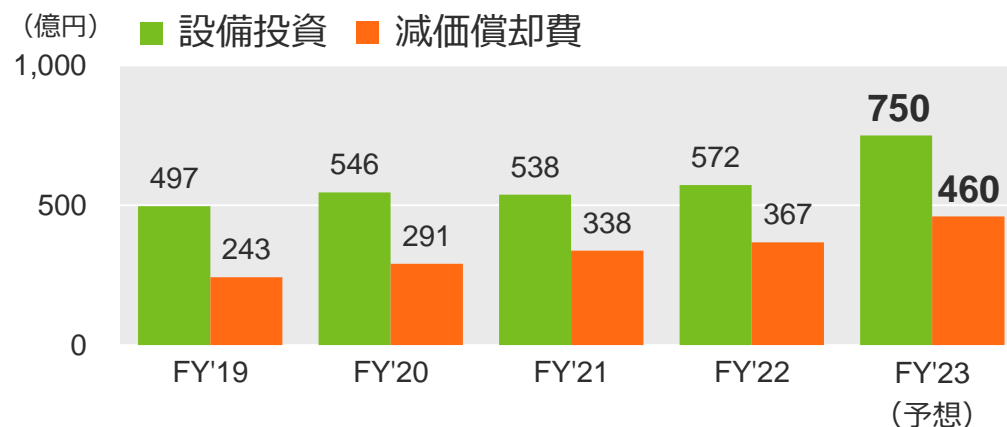
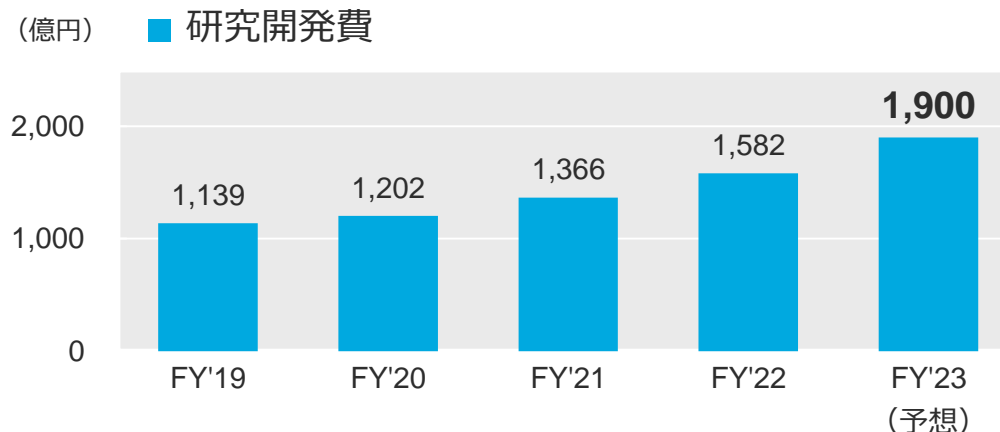


熊本県合志市：建設費約300億円  
(2024年秋 竣工予定)

新開発棟  
(エッチング装置)



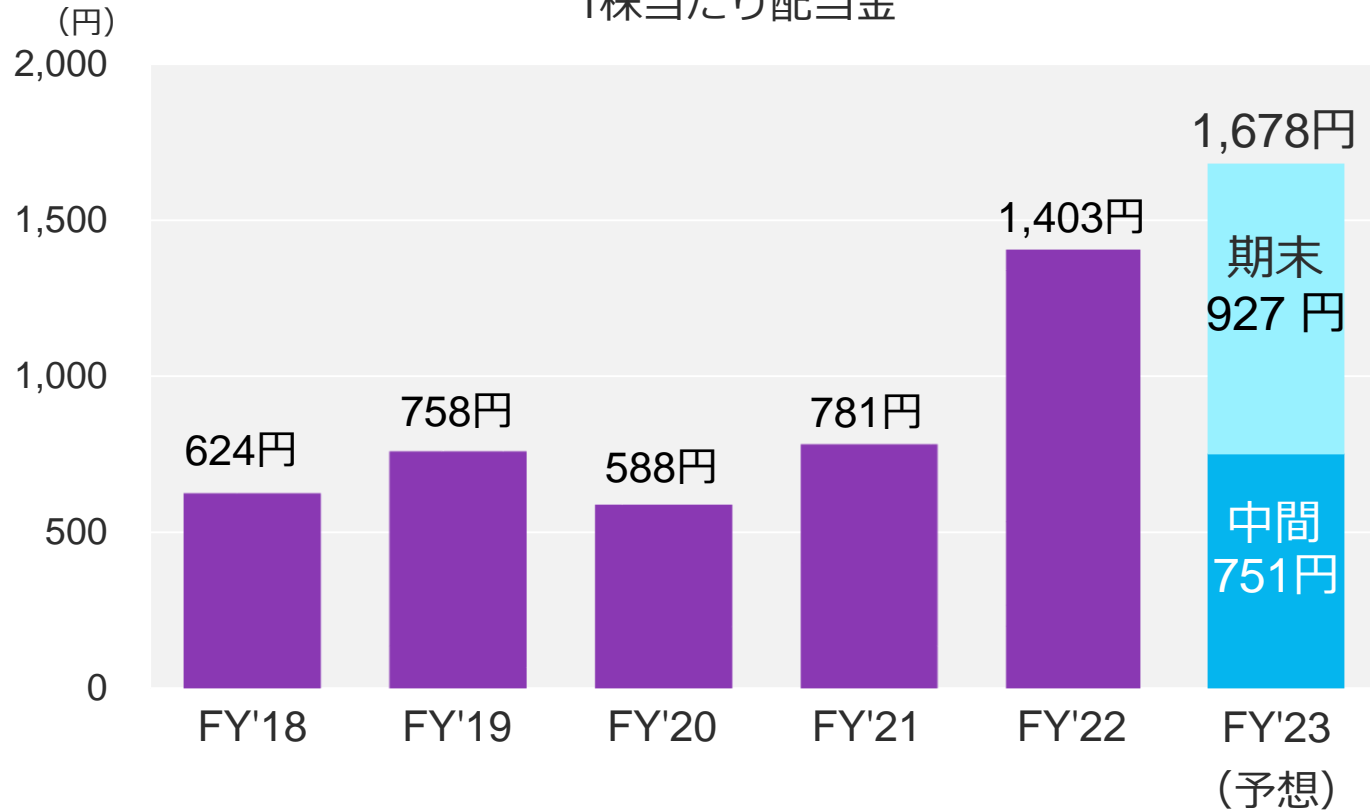
宮城県黒川郡：建設費約470億円  
(2025年春 竣工予定)



拡大する市場と多様化する最新技術ニーズを見据え、  
研究開発、設備投資を加速

# FY2023 配当予想

1株当たり配当金



## 当社の株主還元策

連結配当性向： 50%

但し、1株当たり年間配当金150円を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得： 機動的に実施を検討

通期配当金は1,678円を予定

# 中期経営計画

(億円)

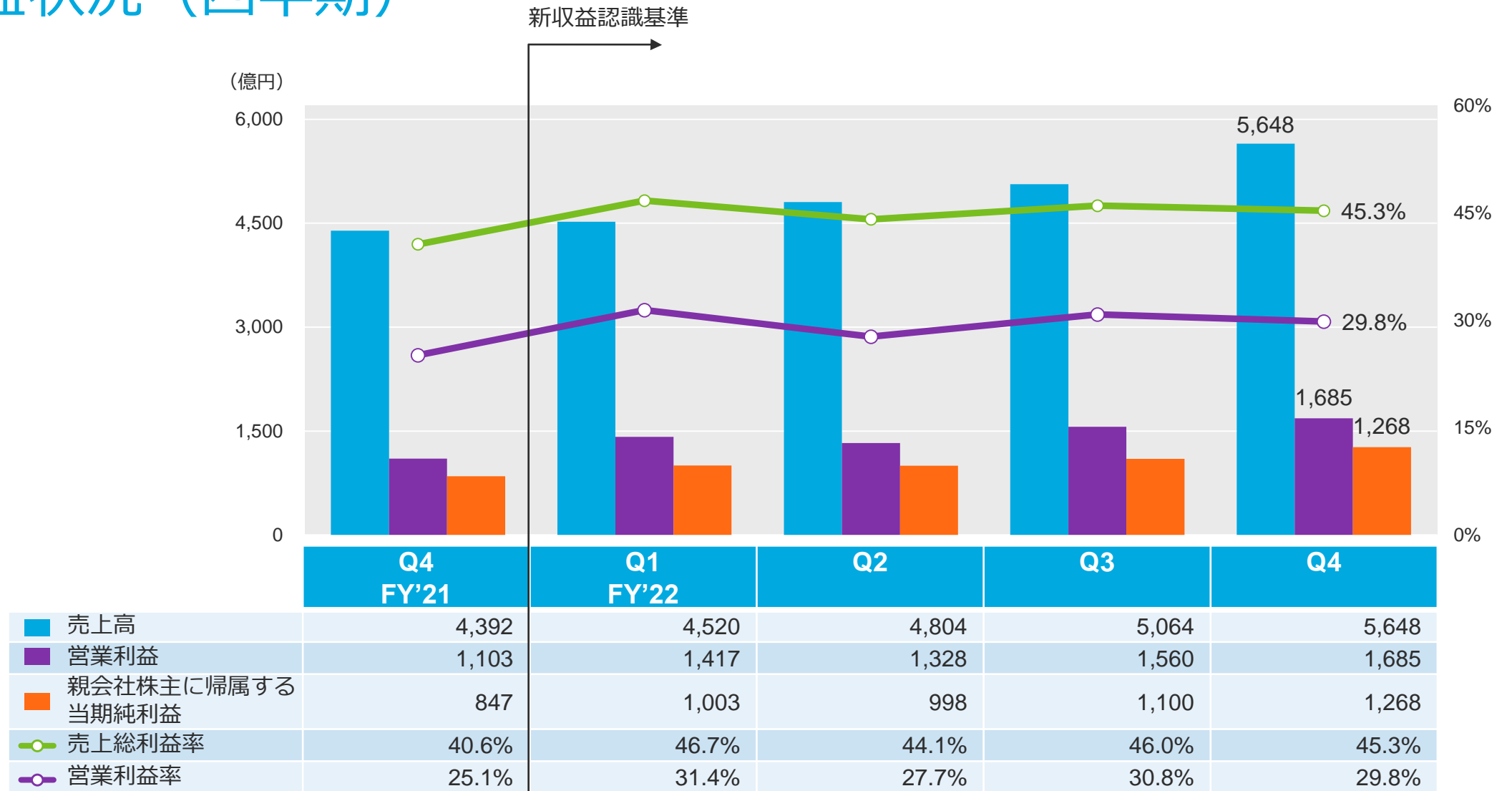
	FY2021 (実績)	FY2022 (実績)	By FY2024 (計画)		
売上高	13,991	<b>20,038</b>	15,000	17,000	<b>20,000</b>
売上総利益	5,649	<b>9,118</b>	6,500	7,400	<b>8,900</b>
下段：売上総利益率	40.4%	<b>45.5%</b>	43.3%	43.5%	<b>44.5%</b>
販管費	2,442	<b>3,125</b>	2,520	2,640	<b>2,900</b>
下段：売上高販管費比率	17.5%	<b>15.6%</b>	16.8%	15.5%	<b>14.5%</b>
営業利益	3,206	<b>5,992</b>	3,980	4,760	<b>&gt;6,000</b>
下段：営業利益率	22.9%	<b>29.9%</b>	26.5%	28.0%	<b>&gt;30.0%</b>
ROE	26.5%	<b>37.2%</b>	<b>&gt;30%</b>		

売上高 2兆円を想定した財務モデルを2年前倒しで達成。  
さらなる成長に向け、新中期経営計画を策定中

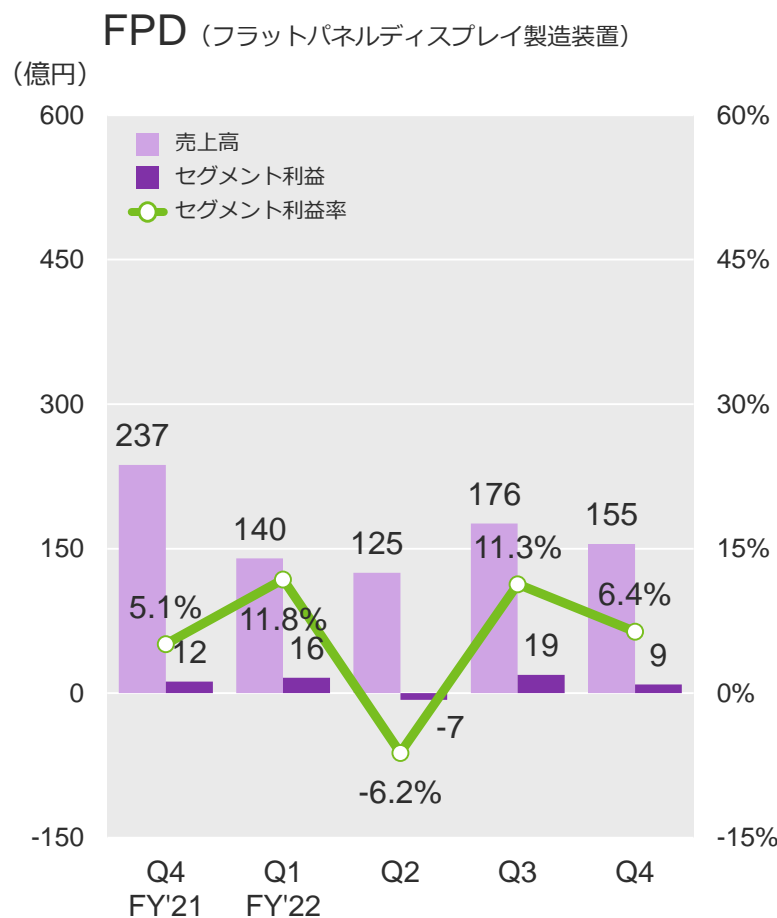
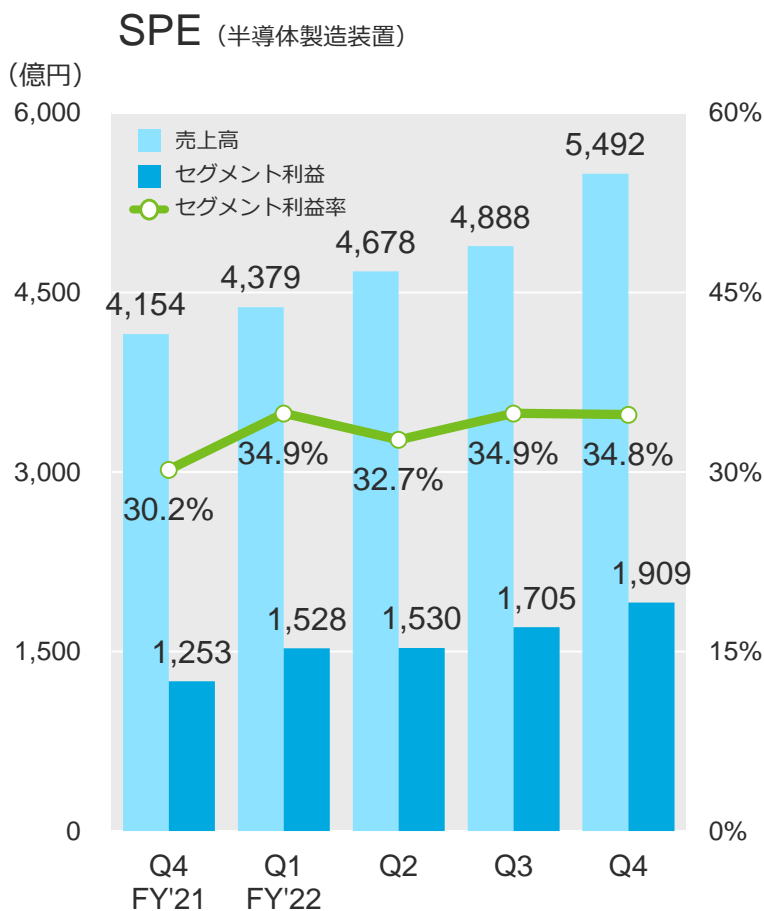
# 補足資料



# 損益状況（四半期）

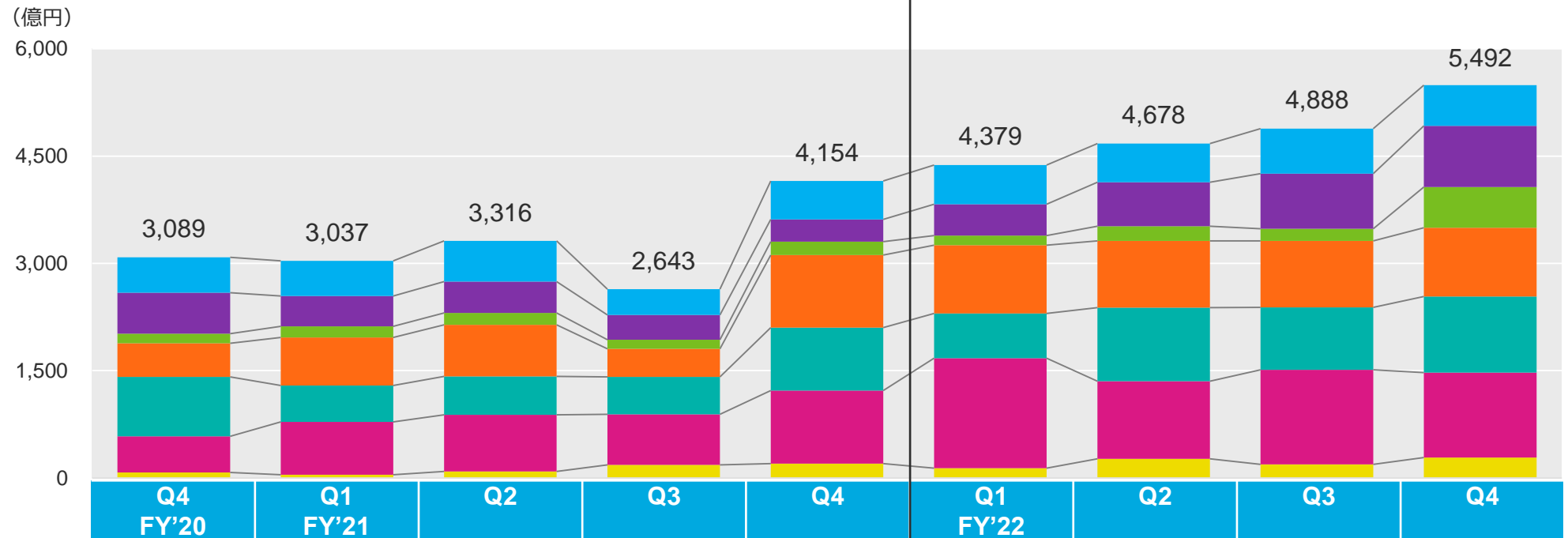


# セグメント情報（四半期）



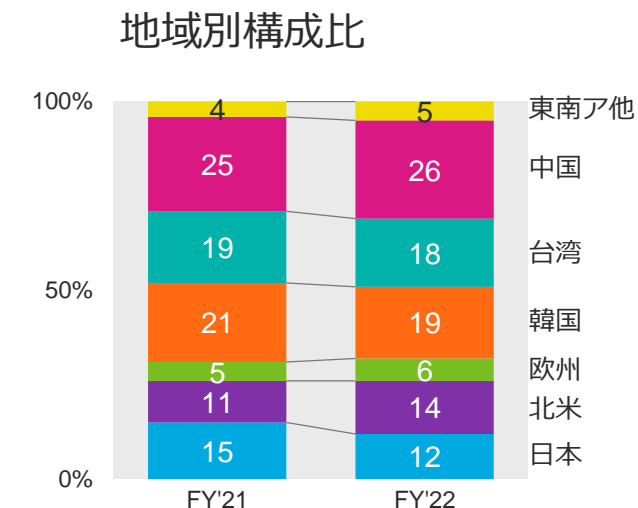
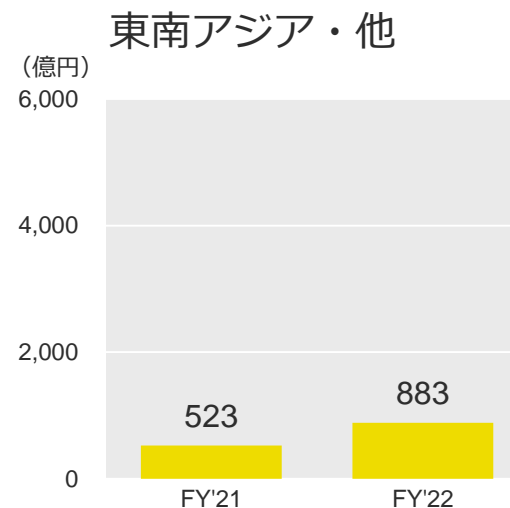
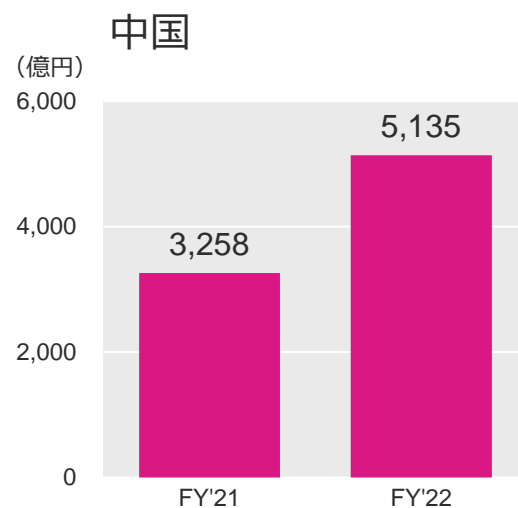
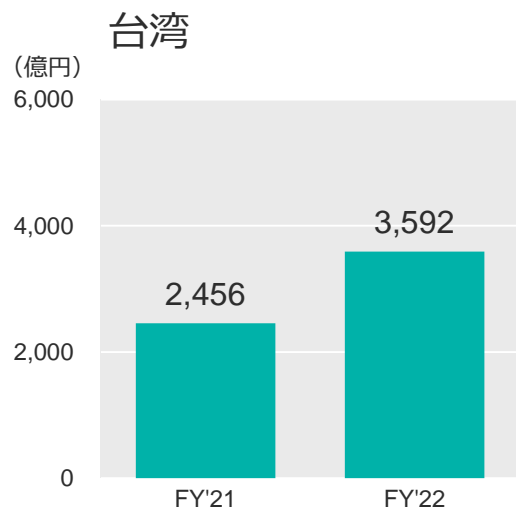
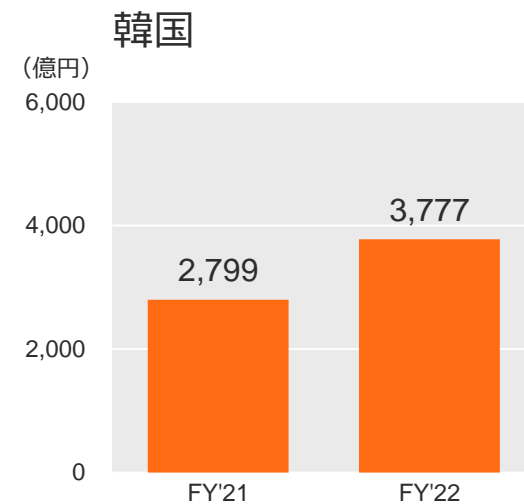
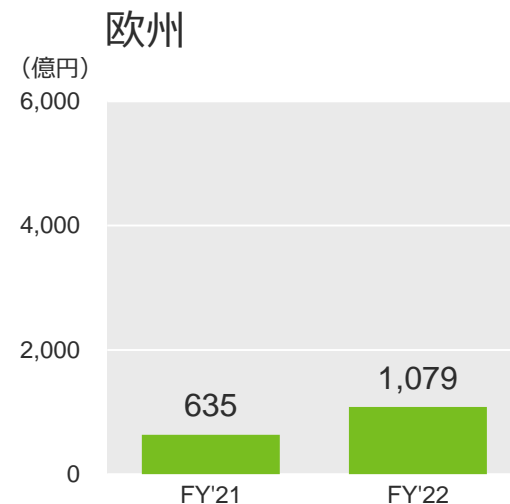
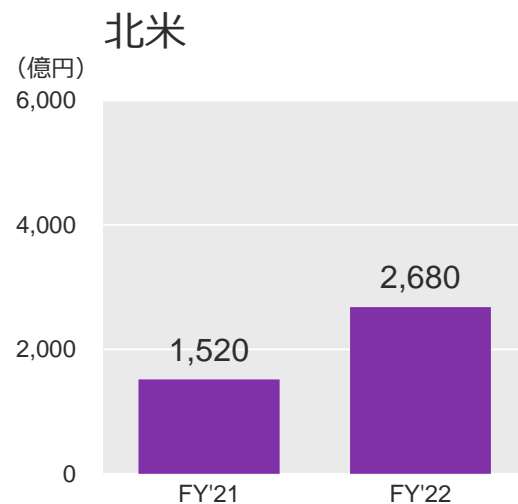
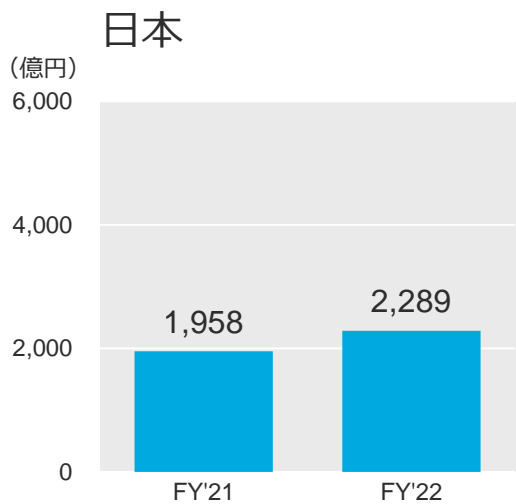
1. セグメント利益は、税金等調整前当期純利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない基礎研究又は要素研究等の研究開発費、およびその他の一般管理費等があります。
3. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。

# SPE部門 地域別売上高 (四半期)

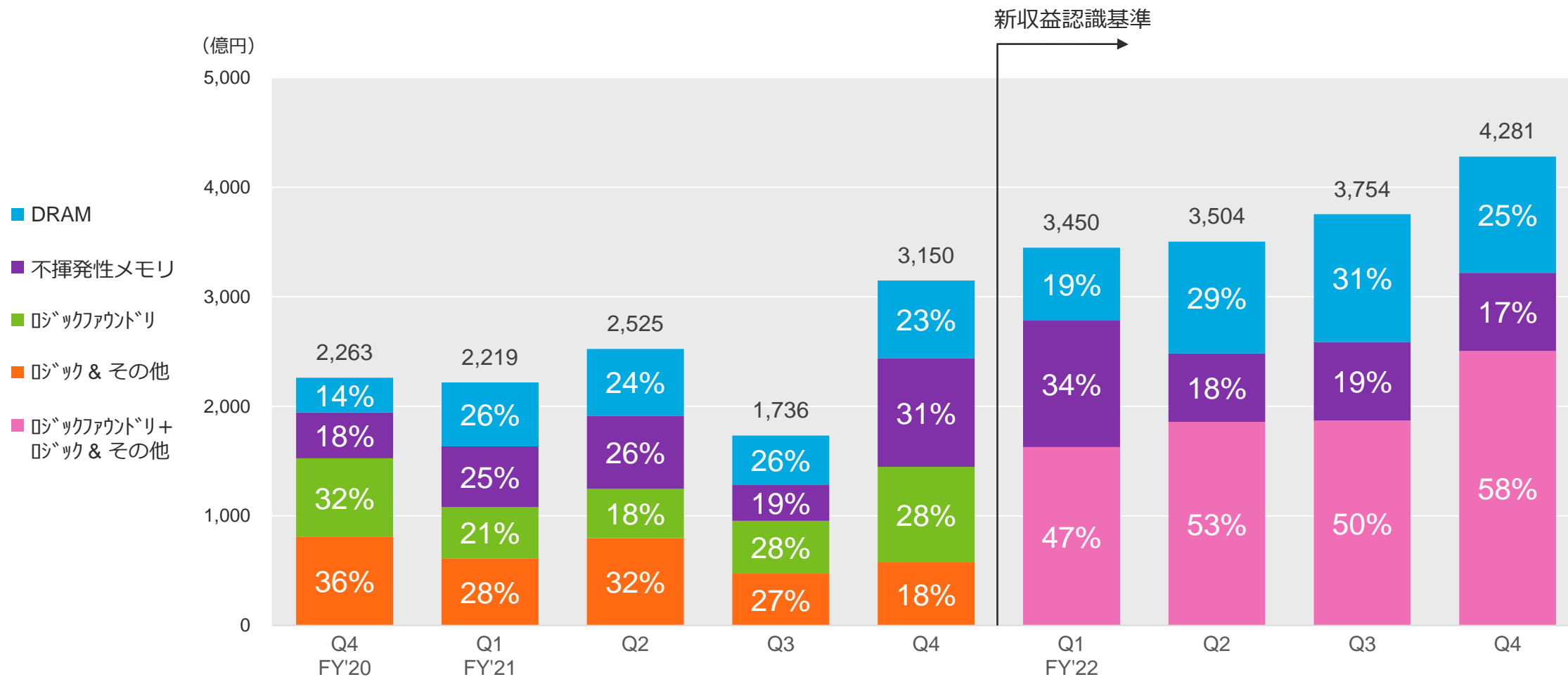


	Q4 FY'20	Q1 FY'21	Q2	Q3	Q4	Q1 FY'22	Q2	Q3	Q4
日本	496	491	568	361	536	548	539	631	569
北米	572	423	440	345	312	439	618	768	853
欧州	133	157	163	127	186	134	203	170	571
韓国	471	670	721	393	1,014	953	935	930	959
台湾	831	509	539	525	882	628	1,025	874	1,063
中国	506	739	791	705	1,022	1,536	1,088	1,322	1,188
東南アジア・他	77	46	92	184	200	138	267	189	287

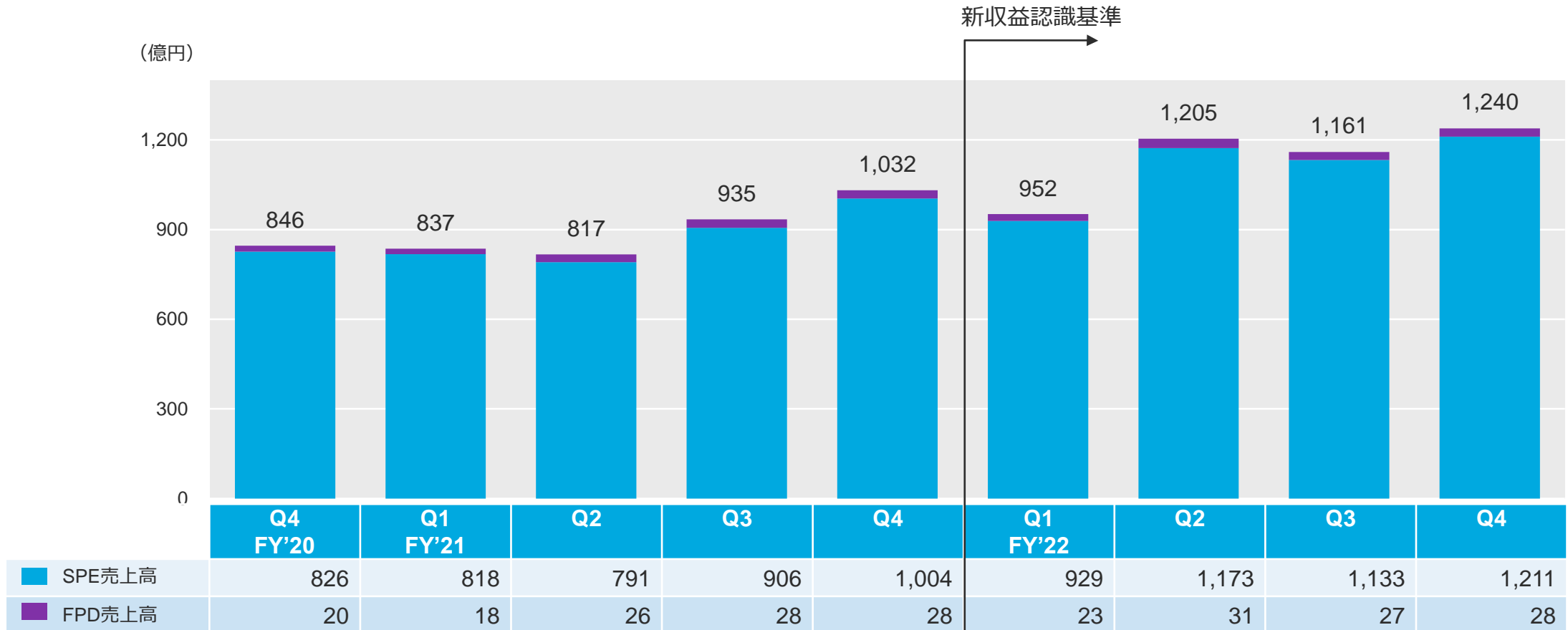
# SPE部門 地域別売上高



# SPE部門 新規装置 アプリケーション別売上構成比（四半期）

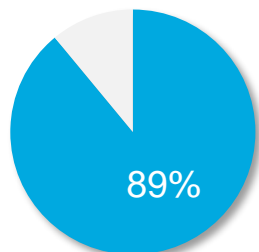


# フィールドソリューション売上高（四半期）

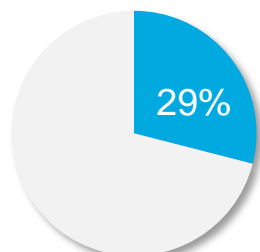


# TEL™ 主要プロダクト 世界市場シェア (CY2021)

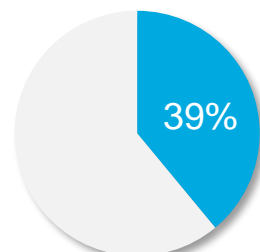
## 半導体製造装置



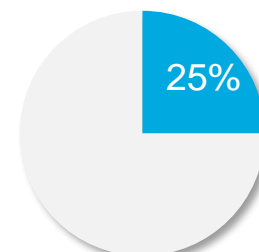
コータ/デベロッパ



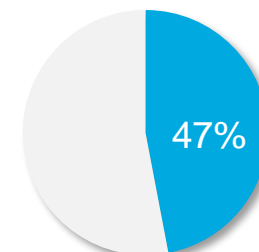
ドライエッチング装置



成膜装置

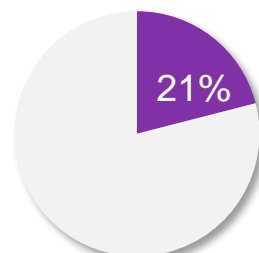


洗浄装置

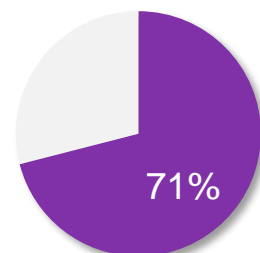


ウェーハプローバ\*

## FPD製造装置 (FY2022)

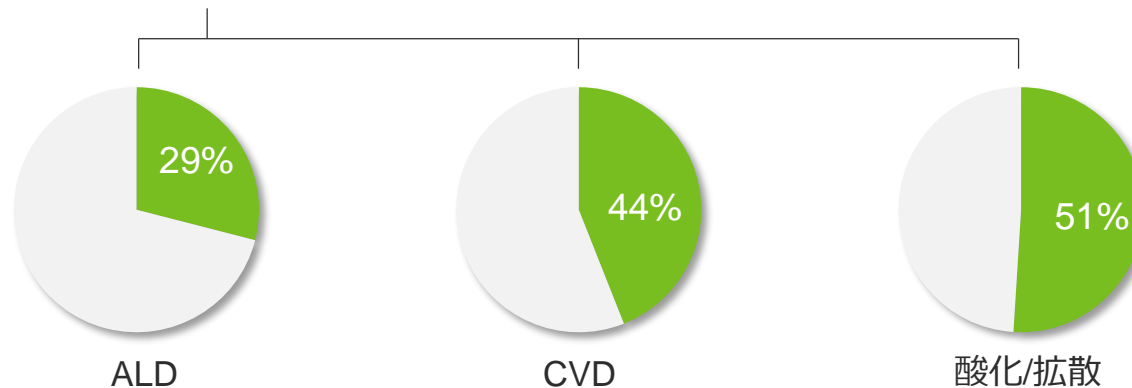


FPDコータ/デベロッパ



FPDプラズマエッチング装置

出所 (FPD) : 当社推定



出所

半導体製造装置 (ウェーハプローバを除く) : Gartner®, Market Share: Semiconductor Wafer Fab Equipment, Worldwide, 2021, Bob Johnson, Gaurav Gupta, 7 April 2022 図はガートナーリサーチに基づき、東京エレクトロンが作成。  
 コータ/デベロッパ: Photoresist Processing (Track), ドライエッチング装置: Dry Etch, 成膜装置: Tube CVD + Atomic Layer Deposition Tools + Oxidation/ Diffusion Furnaces + Nontube LPCVD, ALD: Atomic Layer Deposition Tools, CVD: Tube CVD + Nontube LPCVD, 酸化/拡散: Oxidation/Diffusion Furnaces, 洗浄装置: Single Wafer Processors + Wet Stations + Batch Spray Processors + Scrubbers + Other Clean Equipment GARTNERは、Gartner Inc.または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved.

\*半導体製造装置 (ウェーハプローバ) : TechInsights Manufacturing Analysis Inc. (VLSIresearch), April 2022 図はTechInsights Manufacturing Analysis Inc. (VLSIresearch)に基づき、東京エレクトロンが作成。

**TEL**™

**TOKYO ELECTRON**